



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102026487 A

(43) 申请公布日 2011. 04. 20

(21) 申请号 201010588130. 3

(22) 申请日 2010. 12. 15

(71) 申请人 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

地址 130033 吉林省长春市东南湖大路
3888 号

(72) 发明人 毛书勤 许艳军 衣伟

(74) 专利代理机构 长春菁华专利商标代理事务所 22210

代理人 张伟

(51) Int. Cl.

H05K 3/00 (2006. 01)

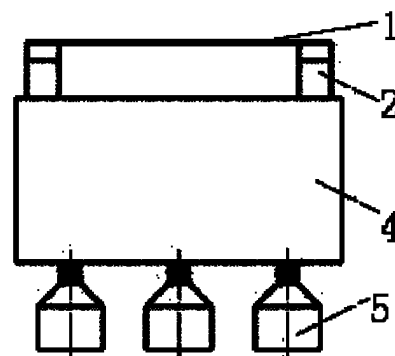
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 发明名称

印制电路板灌封平台

(57) 摘要

本发明涉及电子装联技术领域,特别是一种印制电路板灌封平台。本发明包括印制电路板卡板、导轨、调平指示气泡、支撑平台和调整螺钉,所说的调平指示气泡固定在支撑平台上面中心部位,所说的两个导轨分别装在支撑平台上端面的相平行的两个边上,印制电路板卡板放置在导轨上面,所说的调整螺钉固定在支撑平台的底部。本发明结构简单,使用方便,为印制电路板灌封工作提供了专门的操作平台,大大提高了工作效率和工作质量。



1. 印制电路板灌封平台，其特征在于，包括印制电路板卡板 (1)、两个导轨 (2)、调平指示气泡 (3)、支撑平台 (4) 和调整螺钉 (5)，所说的调平指示气泡 (3) 固定在支撑平台 (4) 上面中心部位，所说的两个导轨 (2) 分别装在支撑平台 (4) 上端面的相平行的两个边上，印制电路板卡板 (1) 放置在导轨 (2) 上面，所说的调整螺钉 (5) 固定在支撑平台 (4) 的底部。

2. 根据权利要求 1 所述的印制电路板灌封平台，其特征在于，所说的导轨 (2) 呈长方体，其上面开有贯通导轨 (2) 的凹槽。

3. 根据权利要求 1 所述的印制电路板灌封平台，其特征在于，所说的两个导轨 (2) 平行。

4. 根据权利要求 1 所述的印制电路板灌封平台，其特征在于，所说的印制电路板卡板 (1) 呈片状。

5. 根据权利要求 1 所述的印制电路板灌封平台，其特征在于，所说的两个印制电路板卡板 (1) 平行。

6. 根据权利要求 1 所述的印制电路板灌封平台，其特征在于，所说的调整螺钉 (5) 有三个，在支撑平台 (4) 底部呈三角形。

印制电路板灌封平台

技术领域

[0001] 本发明涉及电子装联技术领域，特别是一种印制电路板灌封平台。

背景技术

[0002] 目前，印制电路板灌封操作只能在普通的防静电操作台上进行。在灌封过程中，由于器件高度各不相同又没有专门的卡具固定印制电路板，只能将印制电路板置于桌面通过底面加填充物垫平印制电路板。此种做法既无法保证填充物完全垫平印制电路板，印制电路板本身也容易遭受到填充物的污染，不仅操作不便而且印制电路板灌封胶在固化过程中经常出现由于电路板不平而造成的整体偏斜情况（即一侧胶多，一侧胶少），使得印制电路板的灌封质量受到较为严重的影响。因此，研制出一种新型的印制电路板灌封平台势在必行。

发明内容

[0003] 针对上述情况，为解决现有技术的缺陷，本发明的目的就在于提供一种印制电路板灌封平台，可有效解决由于固定印制电路板不平而使灌封质量受到影响的问题。

[0004] 本发明解决技术问题所采用的技术方案是，印制电路板灌封平台，包括印制电路板卡板、两个导轨、调平指示气泡、支撑平台和调整螺钉，所说的调平指示气泡固定在支撑平台上面中心部位，所说的两个导轨分别装在支撑平台上端面的相平行的两个边上，印制电路板卡板放置在导轨上面，所说的调整螺钉固定在支撑平台的底部。

[0005] 本发明结构简单，使用方便，为印制电路板灌封工作提供了专门的操作平台，大大提高了工作效率和工作质量。

附图说明

[0006] 图 1 是本发明的印制电路板灌封平台的主视图。

[0007] 图 2 是本发明的印制电路板灌封平台的侧视图。

[0008] 图 3 是本发明的印制电路板灌封平台的俯视图。

[0009] 图 4 是本发明的印制电路板灌封平台的仰视图。

[0010] 图 5 是本发明的印制电路板灌封平台的 A-A 剖视图。

[0011] 图中，1、印制电路板卡板，2、导轨，3、调平指示气泡，4、支撑平台，5、调整螺钉。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图对本发明的具体实施方式做详细说明。

[0013] 由图 1-5 所示，本发明的印制电路板灌封平台，其特征在于，包括印制电路板卡板 1、两个导轨 2、调平指示气泡 3、支撑平台 4 和调整螺钉 5，所说的调平指示气泡 3 固定在支撑平台 4 上面中心部位，所说的两个导轨 2 分别装在支撑平台 4 上端面的相平行

的两个边上，印制电路板卡板 1 放置在导轨 2 上面，所说的调整螺钉 5 固定在支撑平台 4 的底部。

[0014] 由图 3 所示，所说的导轨 2 呈长方体，其上面开有贯通导轨 2 的凹槽。

[0015] 所说的两个导轨 2 平行。

[0016] 所说的印制电路板卡板 1 呈片状。

[0017] 所说的两个印制电路板卡板 1 平行。

[0018] 由图 4 所示，所说的调整螺钉 5 有三个，在支撑平台 4 底部呈三角形。

[0019] 本发明的印制电路板灌封平台通过三点调平装置、气泡指示调平以及滑轨与卡板组合成功解决了印制电路板灌封过程中印制电路板的调平与固定问题。印制电路板卡板 1 用于固定印制电路板，可沿导轨 2 移动；导轨 2 距离支撑平台 4 本体有一定高度，主要是为电子元器件的高度留有空间。

[0020] 本发明结构简单，使用方便，大大提高了印制电路板灌封的工作效率与质量。

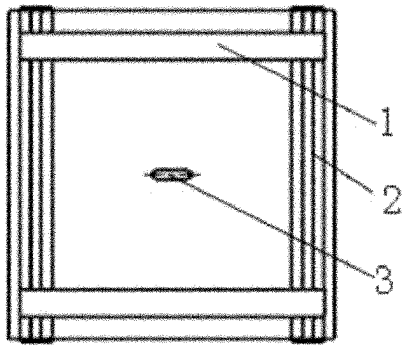


图 1

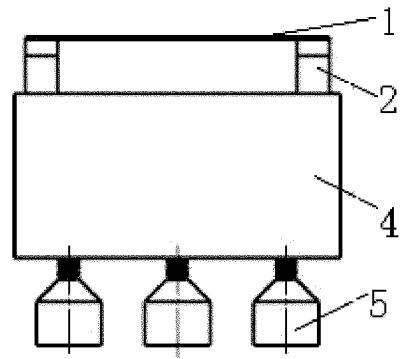


图 2

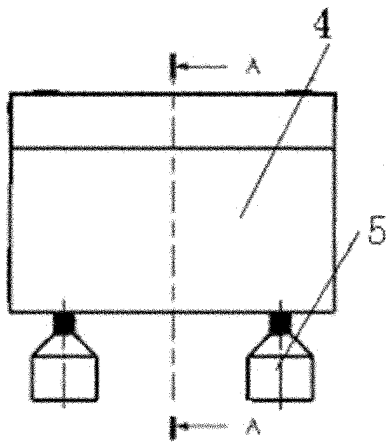


图 3

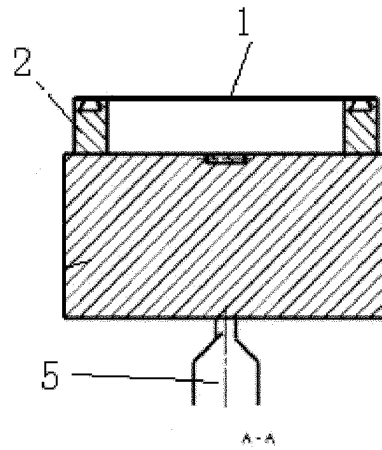


图 4

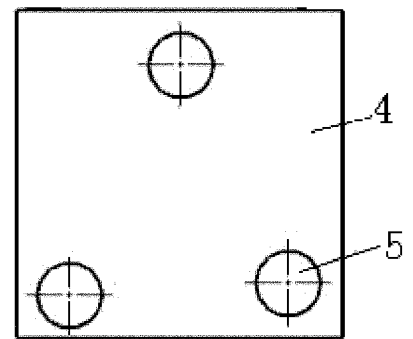


图 5